

证券代码：000021

证券简称：深科技

## 深圳长城开发科技股份有限公司

### 2025年2月21日投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安 华夏基金 宝盈基金 大兴华旗
时间	2025年2月21日
地点	公司本部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书钟彦 证券事务代表刘玉婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service, EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1. 请问公司2024年的主要业务增长点有哪些，这些增长点对公司的</p>

业绩贡献分别是多少？

答：公司2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润6.61亿元，同比增加48.12%，主要原因是公司存储半导体业务和计量智能终端业务的增长。

2. 公司半导体先进封装和测试的技术如何？

答：作为国内领先的内存芯片封装测试企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。公司现有的技术水平可以满足现有客户的需求和未来发展的需要，未来将根据客户需要布局相关能力。

3. 计量智能终端业务的开发科技在北交所上市进度？

答：深科技成都（开发科技）已通过北交所上市委员会审核，目前处于提交注册阶段，尚需履行中国证监会注册等相关程序，后续公司将根据上市进展情况，及时履行信息披露义务，敬请关注并注意投资风险。

4. 公司在AI和大模型方面有何应用和规划？

答：公司作为全球领先的专业电子制造企业，从智能制造、智慧供应链和数字化运营三方面完善数字化转型战略，在助力生产运营提质增效的同时，以数字技术驱动供应链综合管理能力提升。以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展。未来，公司将持续关注新兴技术的发展和应用，例如，在机器视觉识别领域，公司将继续加大成熟技术的应用推广及方案改善，通过接入大模型建立深科技的AI知识中台，充分利用AI能力拓展业务知识广度，在制造设备、产品工艺、供应链、精益等专业领域进行实践。

5. 公司如何展望未来经营业绩情况？

答：公司董事会及经营管理层通过聚焦主责主业持续提升核心竞争力、优化体制机制激发企业活力、完善合规风控体系建设加强防御风险能力，通过精益化管理，持续提高运营效率，降低管理成本，提升盈利水平。未来，公司将加强科技创新，着力形成新质生产力，聚焦主责主业，着力提高发展质量，贴近客户需求，着力提升产供应链韧性和效能，打破思维惯性，着力优化适应高质量发展的生产关系，以进一步提升盈利水平，为股东创造价值和回报。

	接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 (如有)	无
日期	2025年2月21日